

Encapsulix



Nombre de RH : 1

Durée de l'entretien : 20 min

Général

Encapsulix a été fondée pour répondre à l'exigence de mise à l'échelle géométrique de dépôts de couches atomiques (ALD) critiques pour les dispositifs et les feuilles industrielles et microélectroniques. Notre procédé initial est focalisé sur les couches minces d'Al₂O₃, de TiO₂ et de ZnO spécifiquement pour l'encapsulation.

Implantation

Notre siège social et notre centre de recherche sont situés dans le sud de la France, le développement de produits en Californie et les ventes et services sont à New York, États-Unis. Notre équipe de direction a plus de 100 ans d'expérience dans les semi-conducteurs et les équipements de dépôts de couches minces.

Actualités de l'entreprise

Encapsulix lance la machine infinity™ M200D, dernier membre de la gamme de produits d'équipements ALD industrielle infinity™. La machine M200D dépose des couches nanoscopiques d'oxyde ainsi que des nanolaminats sur des substrats ayant des dimensions jusqu'à 200mm x 200mm. Elle cible des applications dans des organisations de R & D travaillant sur une variété de composants à couches minces, tels que les écrans OLED pour les appareils connectés (lunettes intelligentes, montres intelligentes ou écrans de téléphones flexibles), le photovoltaïque avancé ou les batteries couches minces.

Chiffre d'affaires : -

Nombre d'employés : -

Domaine d'activité :

Microélectronique

Date de création : -

Site Web :

www.encapsulix.com

Produits : Dépôts de couches sur dispositifs microélectroniques

Origine de l'entreprise : France

